

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

IoT 化が進む中、電子基板を中心に確実に成長し、新規分野へ積極的に投資する

◆2017年3月期(第48期)業績トピックス

為替は、想定レート1ドル105円に対し110円で推移したが、前年に比べ円高になった。為替の影響は当期より当社から子会社に売る原材料費を考慮に入れたため、影響が大きくなった。薬品の出荷量は前期比5.5%増、販売管理費は新社屋の竣工、人件費の増加により前期比8%増となった。今期から日本メックの決算期を変更し、毎年12月31日までとする。

◆2017年3月期(第48期)業績詳細

常務執行役員管理本部長 北村 伸二

売上高は92億59百万円(前期比1億81百万円増、修正計画比2億59百万円増)営業利益は18億87百万円(同2億98百万円減、87百万円増)となった。経常利益は18億88百万円(同3億19百万円減、68百万円増)である。親会社株主に帰属する当期純利益は16億42百万円(同1億27百万円増、1億92百万円増)となった。

流動資産のその他は、主に尼崎事業所建設に伴う消費税と売上にかかる消費税の差額が未収となり、2億82百万円増加した。有形固定資産の建設仮勘定は、尼崎事業所関係の本勘定への振替により17億36百万円減少し、建物および構築物、機械装置および運搬具が増えた。尼崎事業所建設資金を20億円借入れ、そのうち2億50百万円を返済し、長期借入金が12億50百万円、1年以内返済予定の長期借入金が5億円となった。自己株式20万株の取得および株式報酬制度の会計処理に伴う資本剰余金への振替により、自己株式が2億43百万円減少した。結果、負債純資産合計が179億93百万円(前期比22億78百万円増)となった。

売上は第2四半期をボトムに伸びたが、営業利益は尼崎事業所の引越し代等が発生し、第3四半期をトップに第4四半期は少し落ちた。経常利益、純利益も同様の傾向だが、日本単体では税率低減により極端に増えている。品別別では薬品比率が95.7%、薬品別では銅表面処理剤が90%以上と圧倒的に高く、売上、出荷数量ともにCZ等の密着向上剤、EXE等のエッチング剤が伸びている。CZシリーズの売上は、第2四半期をボトムに増加している。地域別では、日本は安定しており、アジアは第2四半期をボトムに伸長してきた。欧州は第1四半期、第2四半期が良好で、第3四半期、第4四半期は安定している。

決算期変更により、今期は日本単体9カ月、海外子会社12カ月という変則決算を行う。

◆2017年12月期通期連結業績予想

社長 前田 和夫

2017年12月期の売上は、86億円の予想である。2016年12月期は、2017年3月期を参考に読替え、日本は3期分、海外子会社は4期分である。2017年12月期の営業利益は11億円(前期比34.7%減)、経常利益は12億円(同29.3%減)、純利益は8億50百万円(同43.9%減)である。営業利益の差異の主な要因は、人件費3億円、尼崎事業所の減価償却費1.5億円の増分である。

◆今後の方向性

IoT 社会が進展する中、当社は基幹事業である電子基板をさらに深掘りし、水平展開をして確実に成長する。また、今まで同様グローバルに展開し、子会社のメンテや営業部員を増加する。電子基板やアマルファ等の構造体に加え、環境や材料等、化学つながりでのさまざまな基礎研究や新規分野への投資を行う。

一番の稼ぎ頭はスマートフォンだが、自動車やスパコン分野にも進出する。インターネットや移動通信のインフラは伸びており、電子基板を通じて注力し、同時に構造分野、エネルギー、材料関連にも広げていく。電子機器市場は、コンピューター、サーバー、データストレージ、モバイル、コミュニケーション、ワイヤレスインフラストラクチャー、自動車等が今後の伸び率が高いと予想され、当社の製品が深く関係している。電子基板の生産額は中国が圧倒的に大きいですが、ASEAN諸国は伸びがよいため、顧客に近いタイに進出する。今後の成長のために必要な投資であり、2018年7月稼働目標に進めている。

当社は、パッケージ基板で高いシェアを獲得しており、また、スマートフォンの HDI 基板や自動車の ADAS 用の基板にも拡大している高周波の基板も強い。用途別では、パソコンやスマホ、自動車が強い。フレキ基板は、つくり方が難しくなってきたり、当社はそこに合わせ込んだ製品、プロセスを投入している。

配線の形成、表面を粗化して物理的な密着性の向上、選択的なエッチングに加え、表面を処理して化学的に密着性を向上させる技術の 4 つをコア技術と位置づけている。今後、高周波対応、超高密度対応が増えてくる。IoT 化が進む中、まず電子基板に注力し、CZ も進化させる。EXE は、普通のマザーボード、やや高付加価値な HDI 基板がさらに細かい配線パターンになり、一部採用されている。UT は、粗化しにくい圧延銅の表面を均一に粗化する薬品である。自動運転では、信号遅延による影響が非常に大きいため、フラットボンド等遅延を起こさない表面処理が必要になってくる。

EXE シリーズは、サブトラ配線パターンが細くなってきたときに、頭が細らないように使われる添加剤である。現状の設備に添加するだけで、かなり高密度なものをつくるのが可能だ。突き詰めると MSAP との競合になるが、MSAP を使わなくても同じようなものをつくるができる。汎用的かつ高密度な部分に幅広く使われるように広げていく。フレキ基板は、今までは曲がる部分に使われていたが、小型の部品を折り畳んでモジュールにして入れる実装部分で非常に多く使われるようになった。UT は、フレキ基板に多く使われる HA 銅箔を密着強化のために粗化するもので、特に配線パターン形成用のドライフィルム前処理として待望されていた。既に市場に出て動き始めており、近い将来の伸びを期待している。高周波の場合、凹凸があると伝送損失が起こるため真っ平らでなければならず、少しずつフラットボンドの需要が増えている。基地局にも新規採用された。アマルファは、一部のアルミのスマホの筐体で使用され、少しずつ伸ばしている。アルミだけでなく、SUS、銅等でも当社の技術が使われるようにしたい。

本社工屋が 2016 年 10 月に竣工した。IoT 化を支え、グローバル化を強化し、樹脂・金属接合関連分野や、それ以外のさまざまな化学の可能性を追求する。技術マーケティングを強化し、本当の意味でのイノベーションを引き起こせるように視野を広げていく。

◆ 質 疑 応 答 ◆

フレキのつくり方がどう変化し、そこで御社の薬品がどのような貢献をするのか。

使われる材料が変わり、樹脂や配線形成用ドライフィルム、レジストとの密着が悪くなってきた。当社の特殊な粗化剤が、その密着の難しい部分に適用されてきており、シェア拡大を目指している。高周波対応ではなく、折り曲げ耐性の向上等である。

3～4年後に新たに増えそうな分野や、10年後の展望について知りたい。

今後増えるのは、フラット処理の分野である。基本的には密着強化で、現状の CZ の置き換えと新規適用分野の両方がある。UT は、粗化しにくい銅箔をきれいに粗化でき、高いポテンシャルがあり、3 年先には主役になる。従来の CZ も増加傾向にある。さらに 10 年先は、高周波対応全体が増えていると思われる。

フラットボンドは、マザーボードで使用するのか、FPGA で使用するのか。

フラットな伝送損失が重視される FPGA のほうが、先に使用されると考えている。

MPU 等も含めて基地局内でのパッケージで、フラットボンドが使われるのか。

タパッケージからマザーボードまですべて、フラットボンドが使われるようになる。

御社からみて、SLP の難しさはどこにあると思うか。

歩どまり等で悩んでいる会社が多い。基本的には、PCB メーカーが MSAP にシフトしており、回路形成が一番難しいようだ。

将来的に EXE を使い、サブトラで SLP のようなものを形成することは可能か。

それを目指して EXE を開発しており、ある程度のところまでは可能と考えている。

(平成 29 年 5 月 16 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>